

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-004

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2020 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

3、业绩预告情况：

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：1,800.00 万元-2,300.00 万元	亏损：13,295.20 万元

注：

公司于 2020 年实施了股权激励计划，并于 2020 年 9 月 14 日授予股权激励对象。公司根据《企业会计准则-股份支付》的规定测算，本年度因股份支付需要确认的费用约为 900 万，上表中相关数据中已扣除该项费用。

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、受益于 5G 及以上技术、物联网等的快速发展，国产替代的加速，以及公司经营策略的转变，公司下游客户结构得到优化，订单和营业收入持续增长，营业收入较上年同期增长 25%-27%，其中电子元器件业务营业收入增长 35%左右。

2、公司部分产品价格有较大幅度上涨，小型化及器件产品的销售比重进一步增加，其中，小型化产品的电子元器件销售比重由 2019 年的 61.90%增加至 2020 年的 65%左右，器件产品的电子元器件销售比重由 2019 年的 24.47%增加至 2020 年的 35%左右，此外，产能利用率较上年大幅提升，产品单位成本下降，毛利率有所提升。

3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 358 万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2020年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021年1月15日